

案例分析：2019年韦尔股份重大资产重组收购豪威科技及思比科（续）



中德证券
Zhong De Securities

Deutsche Bank
德意志银行



豪威科技

- 豪威科技成立于1995年，总部位于美国加州，曾经为NASDAQ上市公司
- 致力于CMOS图像传感器芯片及解决方案的设计及研发，拥有专利近4,000个
- 公司自成立以来一直采取Fabless（无晶圆）业务模式

韦尔股份

- 韦尔半导体成立于2007年，A股主板上市公司
- 半导体分立器件、电源管理芯片的研发设计及半导体产品分销业务
- 十多年的半导体分销业务为韦尔积累了丰富的市场及销售资源

思比科

- 思比科成立于2004年，总部位于北京
- 思比科从事更加低端图像传感器芯片研发设计，产品和客户与豪威科技互补

两步走交易方案设计： 锁定标的、提前协同

第一步：
韦尔股份实际
控制人现金收
购豪威科技
20%股权

第二步：
韦尔股份收
购豪威科技
及思比科
100%股权



中德证券主导的核心环节

- 豪威科技与思比科分别的资产重组方案设计
- 兼顾豪威科技29家财务投资人利益，设计差异化定价及差异化对赌方案
- 豪威科技主要员工股权激励
- 豪威科技一系列符合A股规则的股权结构调整

交易的市场及行业影响力

- 此交易对中国半导体市场的影响意义深远，韦尔股份可通过整合自身渠道优势与豪威科技的品牌和优势，快速提升其市场占有率，短期超越三星，中长期抗衡索尼；同时，作为行业龙头的豪威科技扎根中国资本市场，有助于带动国内半导体产业链上下游的发展